



Version: 24 March 2025



AURUNA[®] 5100

純金鍍液

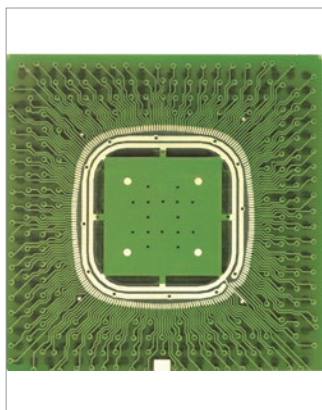


具有良好鍵接性及焊接性的純金鍍層

AURUNA[®] 5100 是中性純金鍍液，以沉積亞光無光澤檸檬黃金鍍層。其研發專為需要有優良鍵接性及焊接性的應用要求。

除了良好延展性，AURUNA[®] 5100 鍍層也展示了低硬度及低接觸抗阻的特性。即使在生產條件下，鍍層可達到 99.99% 高金純度。

鍍層可滿足 ASTM B488-01 Type III Code A/B 的要求



優點

- 非常良好鍍層厚度分佈的純金鍍液
- 高電流效率
- 對覆蓋膜有良好相容性的操作條件
- 優良鍵接性及焊接性能
- 低接觸抗阻
- 符合 ASTM B-488-01 Type III Code A/B 的規格
- 兼容標準 BGA 要求
- 高穩定性鍍液，容易保養

應用

- 硬性及柔性線路板
- 半導體
- BGA應用
- 陶瓷及金屬基材

AURUNA® 5100

純金鍍液

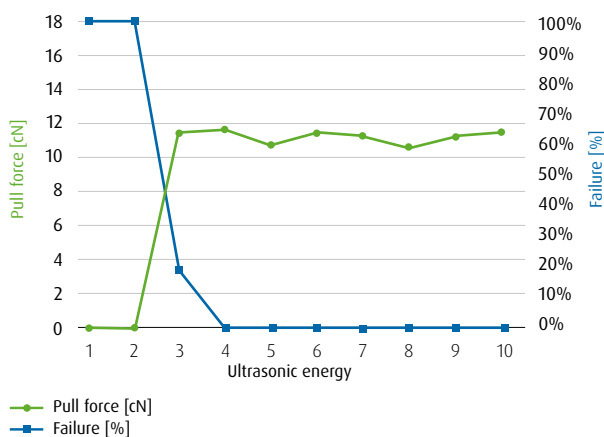


技術規格

鍍液特性	
鍍液種類	中性
金含量	3 - 8 g/l Au
pH 值	6.0 (5.8 - 6.2)
操作溫度	65 (60 - 70) °C
電流密度	0.2 (0.1 - 0.5) A/dm ²
沉積速度	約 0.13 µm/min at 0.2 A/dm ²
陽極物料	鉑鈦

鍍層特性	
鍍層	純金
純度	99.99 % 金
鍍層顏色	檸檬黃
光亮度	亞光, 無光澤
硬度	85 HV
鍍層密度	約 19 g/cm ³

熱超聲鍵接 – 較大處理範圍



Thermosonic device: K&S 4124 (60 kHz)
Au wire type: 25 µm
No. of pulls : 50
Bond distance: 1.7 mm
Loop height: 0.5 mm
Wire deformation: < 1.6

YOUR CONTACT

Do you have a specific question or would you like a no-obligation quote calculation?
Our specialist will be happy to help you with any technical questions you might have.



Markus Legeler
Manager Sales International

Mail: markus.legeler@eu.umicore.com
Phone: +49 (0) 7171 607 - 204

